

ePaste 汎用鉛フリーソルダペースト

SN100C P506 D4



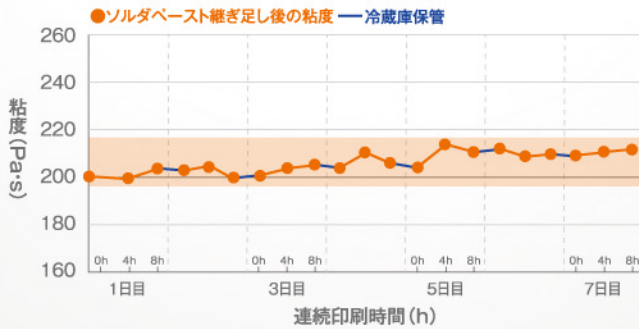
幅広い条件下での使用・保管が可能に!

錫銀銅系はんだと同等の温度プロファイルで使用できる鉛フリーソルダペースト (Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge) です。粘度変化を大幅に抑えることでペーストの保管条件を緩和。繰返し印刷時の経時変化も少なく、廃棄量削減につながります。

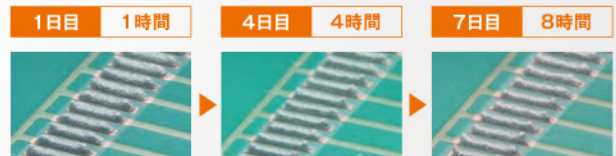
無銀	鉛フリー	汎用品	印刷用
経時安定性良好	サイドボール抑制	ぬれ上がり良好	

繰返し印刷性 粘度上昇が少なく、安定した印刷性を持続

■ 繰返し印刷性試験 (1日8時間×7日間)



■ 印刷形状の外観写真

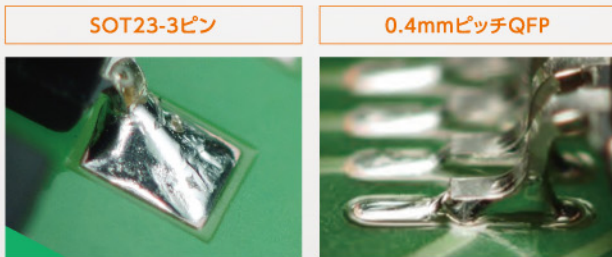


【試験条件】
はんだ充填量: 350g
基板パターン: 0.4mmピッチQFP
メタルマスク厚: 120μm
印刷環境: 25℃ 30~50%RH
印刷速度: 30mm/sec.

【試験条件】
印刷試験を行い0時間、4時間、8時間毎に粘度を測定。4時間毎にはんだを補填し、8時間毎に容器に回収して冷蔵保管。この試験を7日間連続して実施した。

ぬれ上がり リード端面部のぬれ上がりが良好

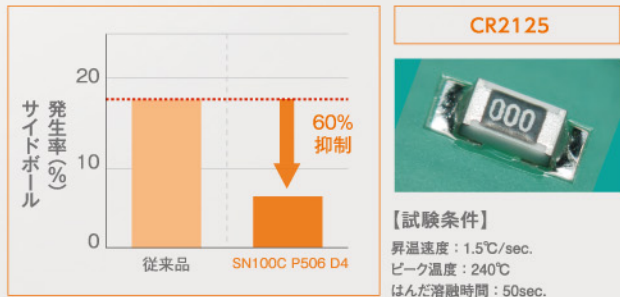
■ はんだ付部の外観写真



【試験条件】
印刷厚: 120μm / 昇温速度: 1.5℃/sec. ピーク温度: 240℃ / はんだ溶融時間: 50sec.

サイドボール 従来品にくらべ発生率を60%抑制

■ サイドボール発生率の比較グラフ



【試験条件】
昇温速度: 1.5℃/sec.
ピーク温度: 240℃
はんだ溶融時間: 50sec.

※上記データ、写真は特定条件下によるものです。